

新卒採用 求人のご案内



◆ 会社概要 ◆

会社名	ティーディーシーソフト カブシキガイシャ <b>TDCソフト株式会社</b>		
所在地	〒102-0074 東京都千代田区九段南1丁目6-5 九段会館テラス TEL03-6730-8111 Fax03-6730-8155 最寄駅 東京メトロ九段下駅4番出口 徒歩1分		
代表者	代表取締役社長 小林 裕嘉	ホームページ	http://www.tdc.co.jp/
創業	1962年10月16日	設立	1963年12月17日
資本金	9億7,040万円	売上高	396億9,805万円【2024年3月期】
株式	上場市場 東京証券取引所 プライム市場（証券コード4687）		
従業員数	2,255名【2025年4月時点】		
事業内容	保険・銀行・クレジット等の金融業や官公庁・法人向けの業務システム開発、インフラ構築などで、お客様に最も信頼されるパートナーを目指したビジネスを行っています。 また、コンサル事業やアジャイル開発、クラウドビジネスにも注力しており、当社が開発したクラウドサービス「Styleflow」や「Meepa」といった様々なソリューションを提供しています。		

◆ 勤務・待遇 ◆

初 任 給 (月 額)	専攻科卒	255,000円	昇 給	年1回(4月)	賞 与	年2回(6月、12月)
			交通費	全額支給		
	本科卒	245,000円	諸手当	時間外・家族・技能一時金 他		
			勤務時間	9：00～17：30 (休憩60分)		
休日休暇	完全週休2日制(土・日)・祝日・夏期・年末年始・年次有給・慶弔・産休・育児・介護 他					
社会保険	健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険					
福利厚生	退職金制度・企業年金基金・クラブ活動補助・社内イベント・ベネフィットステーション 他					
住宅確保支援	初期費用20万円・引越費用負担・下見費用負担あり。【条件・支援詳細は、担当にお尋ねください。】					

◆ 応募要領 ◆

募集職種	システムエンジニア (SE)
仕事内容	システムの提案・設計・開発・運用・保守まで一貫したSI事業。 自社クラウド製品の開発。これらに付帯関連する業務。
応募資格	高等専門学校の全学部・全学科の学生で、 2026年3月卒業/修了予定者および卒業/修了から3年以内の第2新卒者（就業経験無）を対象とする。
選考内容	【内容】面接 【場所】本社 or オンライン 【実施日】弊社より連絡 【提出物】履歴書、学内推薦書
選考フロー (受験順序)	①応募書類の提出 : 推薦者より書類の提出をお願い致します ②WEBテスト : 基礎学力テスト、性格診断テストの受験（可否はありません） ③説明会 : 会社説明会及び採用担当との面談 ④役員面接 : 30分程度の個人面接（面接までに400文字程度の作文提出） 【服装】スーツ（ジャケット着用）※男性はネクタイ着用 【持参】筆記用具（対面の場合のみ）
応募書類	①履歴書及び学校推薦書 ②成績証明書 ③卒業/修了見込証明書 ④健康診断書 【提出日】①申込後～説明会参加前。②③④は内定承諾後、学校から発行され次第の提出。
お問合せ先	人財統括部 採用担当 応募者専用電話 <b>0120-341-922</b> （平日9:00～17:30）携帯電話可 E-mailアドレス <b>saiyou@tdc.co.jp</b>

※内容は都合により変更する場合があります。ご了承ください。

※遠方からの応募の方は選考日程の調整をしますので、採用担当までお問い合わせください。

